(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

정정판

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일
2025 년 9 월 11 일 (11.09.2025)

WIPO | PCT

(10) 국제공개번호
WO 2025/187863 A8

(51) 국제특허분류:
*B24B 37/22* (2012.01) *B24D 3/00* (2006.01)
*B24B 37/24* (2012.01) *B24D 7/14* (2006.01)
*B24D 3/32* (2006.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2024/005945

(22) 국제출원일: 2024 년 5 월 2 일 (02.05.2024)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2024-0032554 2024 년 3 월 7 일 (07.03.2024) KR

(71) 출원인: **케이피엑스케미칼 주식회사 (KPX CHEMICAL CO., LTD)** [KR/KR]; 04143 서울특별시 마포구 마포대로 137 (KR).

(72) 발명자: **민병주 (MIN, Byung Ju)**; 22734 인천광역시 서구 청라에메랄드로 156, 202동 2001호 (KR). **김승근 (KIM, Seung Geun)**; 18466 경기도 화성시 동탄순환대로26길 81, 458동 303호 (KR). **홍석지 (HONG, Seok Ji)**; 18444 경기도 화성시 동탄문화센터로 39, 319동 1501호 (KR). **하태종 (HA, Tae Jong)**; 05649 서울특별시 송파구 양재대로 1218, 204동 2304호 (KR). **이현희 (LEE, Hyun Hee)**; 44745 울산광역시 남구 중앙로47번길 27, 103동 1403호 (KR).

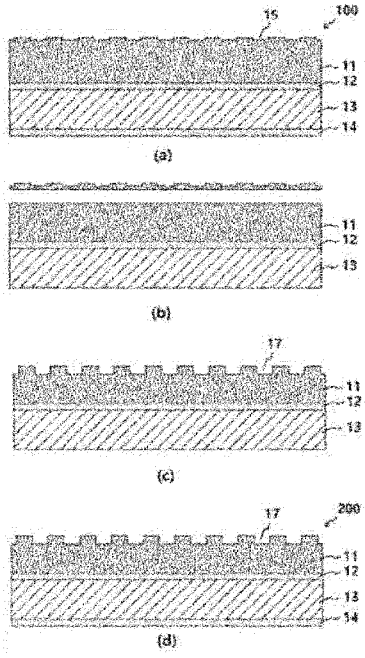
(74) 대리인: **김성호 (KIM, Sung Ho)**; 06221 서울특별시 강남구 언주로85길 24, 3층(역삼동, PNM 타워) (워너비특허법률사무소) (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,

(54) **Title:** POLISHING PAD

(54) **발명의 명칭:** 연마패드




(57) **Abstract:** The present invention provides a polishing pad comprising: an upper pad having grooves formed thereon; and a lower pad positioned below the upper pad, wherein the polishing pad has a value of Cp represented by formula 1 of 0.10 to 1.3.

(57) **요약서:** 본 발명은 그루브가 형성된 상층패드 및 상기 상층패드의 하부에 위치하는 하층패드를 구비하는 연마패드로서, 상기 연마패드는 식 1로 표시되는 Cp의 값이 0.10 내지 1.3인, 연마패드를 제공한다.

WO 2025/187863 A8

[다음 쪽 계속]

TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**공개:**

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

**(48) 본 정정판 공개일:**

2025 년 10 월 2 일 (02.10.2025)

**(15) 정정사항에 관한 정보:**

2025 년 10 월 2 일 (02.10.2025) 자 공지 참조